


# 【0046】先端半導体パッケージ向けDLT装置の機構設計エンジニア　◆東証プライム上場 / 半導体・電子デバイスの最先端技術企業◆

**ウシオ電機株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカトロ設計・...**

## Job Information

**Recruiter**
JAC Recruitment Co., Ltd.

**Hiring Company**
ウシオ電機株式会社

**Job ID**
1613699

**Industry**
Electronics, Semiconductor

**Job Type**
Permanent Full-time

**Location**
Tokyo - 23 Wards

**Salary**
6 million yen ~ 9 million yen

**Work Hours**
08:45 ~ 17:15

**Holidays**
【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 年間有給休暇14日～23日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）...

**Refreshed**
November 28th, 2026 01:00

## General Requirements

**Career Level**
Mid Career

**Minimum English Level**
Business Level

**Minimum Japanese Level**
Native Level

**Minimum Education Level**
Technical/Vocational College

**Visa Status**
Permission to work in Japan required

## Job Description

【求人No NJB2410427】
DLT装置の仕様決定において、顧客の要求事項を把握し、標準機能での対応可否や実現方法を社内や協業先と確認・調整します。
標準仕様で対応できない要望については、要求仕様として整理・展開し、対応の検討を行います。

また、設置環境や搬送条件など装置周辺の機構設計・カスタマイズに関する技術対応、実装された機能・仕様が顧客要求を満たしているかの確認、営業・社内技術部門・協業先との調整を担当します。
顧客や協業先との技術打ち合わせ、メール対応、国内外への出張もあります。

※カスタマイズ設計が中心の業務となります

■本業務の魅力：
・AI・HPC向け半導体を支える、先端パッケージ向けDLT事業に関われる
・成長が期待される新しい事業領域で、顧客要求を製品・装置仕様へ反映できる
・一般的な機構設計に加え、精密装置の設置環境、搬送条件、カスタマイズ設計に関する知識を深められる
・顧客や関係先と技術的な議論を行い、グローバルなプロジェクト推進を経験できる
・機械設計だけでなく、顧客折衝、仕様検討、技術調整、案件推進まで経験できる

※本ポジションは当社入社後、グループ会社（株式会社アドテックエンジニアリング）に出向となります

## Required Skills

■必須要件
・機構設計または機械設計の実務経験
・一般的な工作機械・生産機械などの設置環境や搬送条件に関する基礎知識
・10μmオーダーの精度・公差・仕様について、技術者や顧客と会話できる知識
・顧客要求や仕様を確認し、関係部門と技術的な調整を行った経験
・関係先や顧客とのメールなどに対応できる英語力
※TOEIC500点以上を目安とします
※国内外への出張に対応できる方

■歓迎要件
・工作機械、精密機械、生産機械、自動機などの機構設計経験
・生産設備・製造装置の設計または生産技術の経験
・装置の設置、据付、立上げ、試運転、搬送条件の検討経験
・顧客要求仕様や個別仕様書の作成・確認経験
・装置のカスタマイズ、治具、搬送機構、装置周辺設備などの設計経験
・半導体製造装置、露光装置、電子部品製造装置に関する経験
・海外企業や海外技術部門との技術折衝・調整経験
・英語での技術会議、仕様確認、プレゼンテーションの経験

## Company Description

各種放電ランプ、ハロゲンランプ、レーザーなど光テクノロジーを利用した部品・装置の研究開発・製造